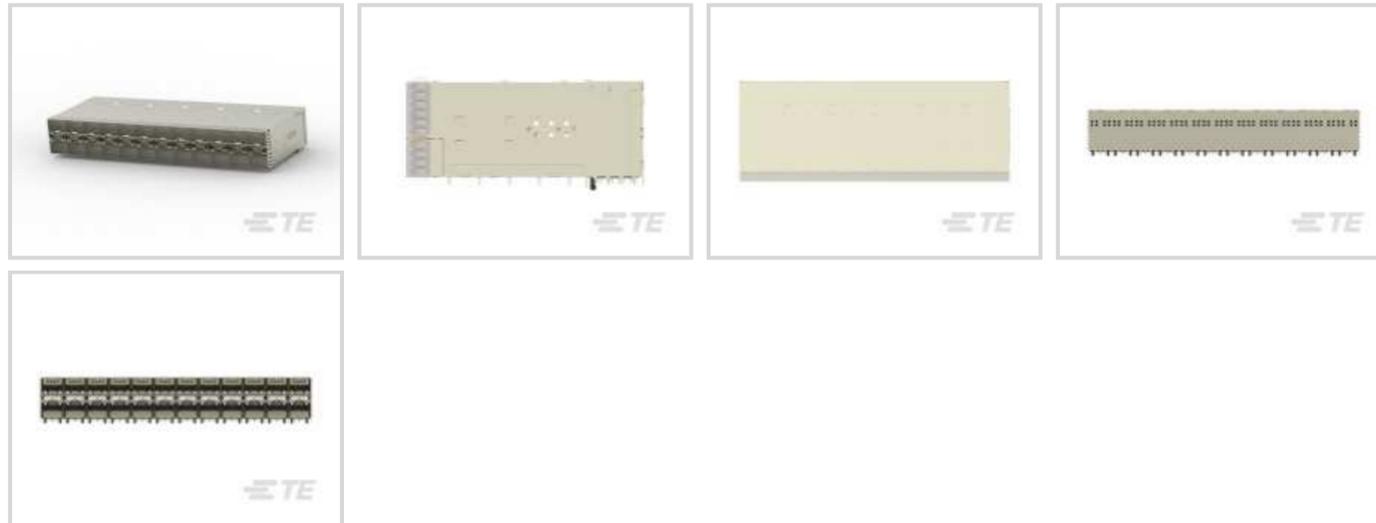




Interne TE-Nummer 2227838-7  
 SFP, SFP+ & zSFP+, Cage Assembly with Integrated Connector,  
 Data Rate (Max) 32 Gb/s, Internal/External EMI Springs, zSFP+  
 Thermally Enhanced

[Auf TE.com ansehen>](#)

Steckverbinder > Pluggable IO-Steckverbinder und -Cages > SFP, SFP+ und zSFP+ > zSFP+ Zweireihiger Cagesatz: EMI-Feder



Steckbarer I/O – Produkttyp: **Cagesatz mit integriertem Steckverbinder**

Datenrate (max.): **32 Gb/s**

Art der EMV-Eindämmung: **Interne/externe EMV-Federn**

Steckbare I/O-Anwendungen: **zSFP+ Thermally Enhanced**

Lichtleiter-Optionen: **Mit Lichtleiter**

[Alle zSFP+ Zweireihiger Cagesatz: EMI-Feder \(45\)](#)

## Eigenschaften

### Produktmerkmale

Formfaktor	zSFP+ Gestapelt (SFP28)
Gehäusotyp	Zweireihig
Steckbarer I/O – Produkttyp	Cagesatz mit integriertem Steckverbinder
Lichtleiter-Optionen	Mit Lichtleiter
Steckverbindersystem	Kabel-an-Leiterplatte
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

### Konfigurationsmerkmale

Anschlussmatrixkonfiguration	2 x 12
Lichtleiterkonfiguration	Doppelt dreieckig (innen)
Lichtleiterausführung	Standard
Anzahl der Anschlüsse	24
Anzahl von Positionen	480

### Elektrische Kennwerte

Datenrate (max.)	32 Gb/s
------------------	---------

### Kontaktmerkmale

Endstückbeschichtungsmaterial	Zinn
Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	.76 µm[29.92 µin]

### Klemmenmerkmale

Anschlussstift- und Restlänge	1.8 mm[.07 in]
Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage – Press-Fit

### Montage und Anschlusstechnik

Art der Steckverbindermontage	Leiterplattenmontage
-------------------------------	----------------------

### Gehäusemerkmale

Gehäusematerial	Nickel-Silberlegierung
Raster	.8 mm[.032 in]

### Abmessungen

Leiterplattendicke (empfohlen)	1.5 mm[.059 in]
--------------------------------	-----------------

### Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	0 – 70 °C[32 – 158 °F]
---------------------------	------------------------

### Betrieb/Anwendung

Kühlkörperkompatibel	Nein
Zur Verwendung mit steckbaren I/O-Produkten	zSFP+ SMT-Steckverbinder
Steckbare I/O-Anwendungen	zSFP+ Thermally Enhanced
Stromkreis Anwendung	Signal

### Industriestandards

UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
----------------------	----------

### Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode	Tray
--------------------	------

### Weitere

Art der EMV-Eindämmung	Interne/externe EMV-Federn
------------------------	----------------------------

### Produkt-Compliance

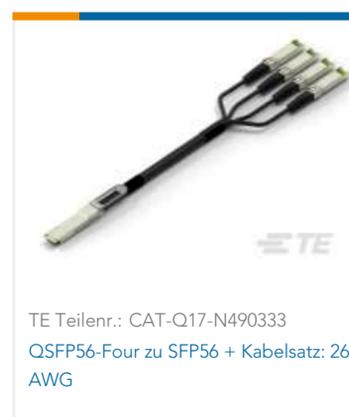
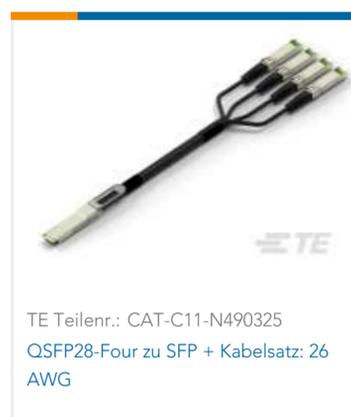
Bitte besuchen Sie die [Produktseite auf TE.com](https://www.te.com) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2023 (233) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

## Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## Kompatible Teile





## Kunden kauften auch diese Produkte



## Dokumente

### CAD-Dateien

3D PDF

3D

### Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2227838-7\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

Englisch

### Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2227838-7\\_A.3d\\_igs.zip](#)

Englisch



## Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2227838-7\\_A.3d\\_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

## Datenblätter/ Katalogseiten

[zSFP+ Interconnect Brochure](#)

Englisch

## Produktspezifikationen

[Anwendungsspezifikation](#)

Englisch

## Umweltverträglichkeit von Produkten

[MD\\_2227838-7\\_03132018236\\_dmtec](#)

Englisch

[MD\\_2227838-7\\_03132018236\\_dmtec](#)

Englisch